

SMD Chip Sicherungen 431.000

SMD Chip Fuses DC

3,2 x 1,6 mm

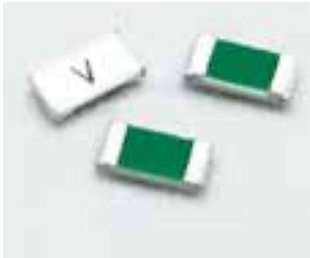
F - flink
quick acting



Spannung 63 V
Voltage

Strom 1 A – 10 A
Current

Ausschaltvermögen 50 A
Breaking capacity



Norm gemäß / *Standard according to:*

Werknorm

Aufbau / *Construction:*

Keramiksubstrate / *Ceramic substrates*
Gehäuse / *Body:* Kupfer, Zinn / *Copper, tin*
Bauform / *Type:* 1206 (3216M)

Anschluss / *Connection:*

Kupfer, Nickel, Zinn / *Copper, Nickel, Tin*
(Bleifrei / *Lead-free*)

Betriebstemperatur / *Operating temperature:*

-55°C bis / *to* 150°C
(De-rating beachten / *consider De-rating*)

Lötbarkeit / *Solderability:*

235°C ± 5°C; t = 5s +0/-0,5s;

Hitzebeständigkeit / *Resistance to heat:*

260°C; t_{max} = 10s (Reflow)

Lagerung / *Storage:*

2 Jahre / *years* @+10°C - +40°C (RH ≤ 75%)

Verpackungsmöglichkeit / *Packing options:*

5.000 Stk. = gegurtet auf Rolle /
5.000 pcs. = *taped & reeled*

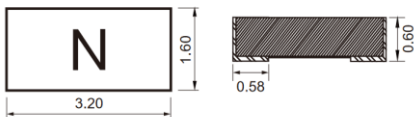
Bemessungswerte / Ratings:

Art. No.	I _N	U _N [V]	U _d [mV]	I _{BC} [A]	I ² t _{melt} [A ² s]
431.017	1 A	63		50	
431.018	1,25 A	63		50	
431.036	1,5 A	63	Auf	50	Auf
431.037	1,75 A	63	Anfrage	50	Anfrage
431.020	2 A	63		50	
431.021	2,5 A	63	/	50	/
431.041	3 A	63		50	
431.038	3,5 A	63	On	50	On
431.023	4 A	63	Request	50	Request
431.024	5 A	63		50	
431.039	6 A	63		50	
431.040	7 A	63		50	
431.026	8 A	63		50	
431.027	10 A	63		50	

I_N - t Verhalten / I_N - t characteristics:

Bemessungsstrom-Faktor / <i>Rated current factor</i>	Schmelzzeit / <i>Melting time:</i>
	1 A
	–
	10 A
2,5 · I _N	t _{min} 0
	t _{max} 5 s
3,5 · I _N	t _{min} 0
	t _{max} 1 s

Maße / Dimensions:



Recommended Pad Layout

